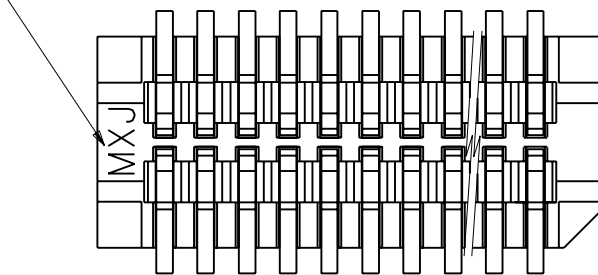


注記 NOTES

1. 嵌合相手: 52465, 52588 シリーズ
MATES WITH: 52465, 52588 SERIES
- △ ウエハーの ϕ から隣接するピンの ϕ 迄の位置を示す。
SHOW POSITION FROM ϕ OF WAFER TO ϕ OF ADJACENT PINS.

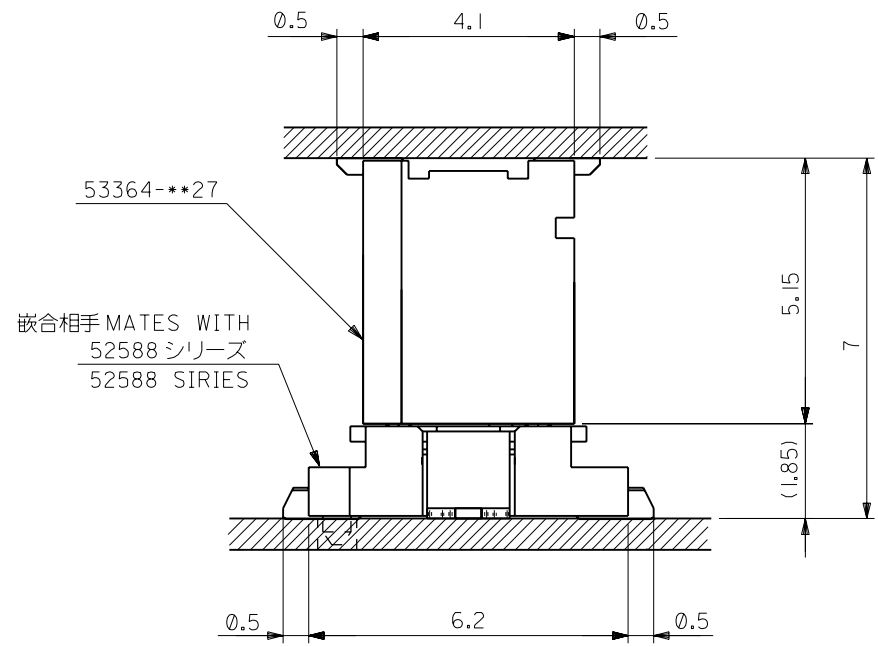
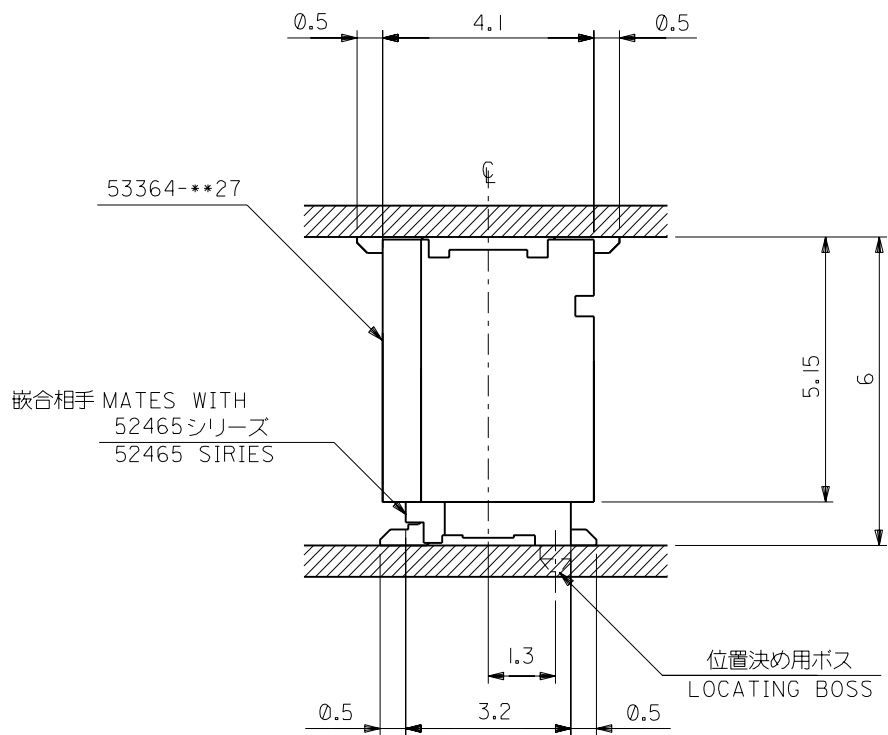
トレードマーク TRADE MARK



0.4	17.8	16.9	15.2	53364-4027	40
0.8	17.0	16.1	14.4	53364-3827	38
0.4	16.2	15.3	13.6	53364-3627	36
0.8	15.4	14.5	12.8	53364-3427	34
0.4	14.6	13.7	12.0	53364-3227	32
0.8	13.8	12.9	11.2	53364-3027	30
0.4	13.0	12.1	10.4	53364-2827	28
0.8	12.2	11.3	9.6	53364-2627	26
0.4	11.4	10.5	8.8	53364-2427	24
0.8	10.6	9.7	8.0	53364-2227	22
0.4	9.8	8.9	7.2	53364-2027	20
0.8	9.0	8.1	6.4	53364-1827	18
0.4	8.2	7.3	5.6	53364-1627	16
0.8	7.4	6.5	4.8	53364-1427	14
0.4	6.6	5.7	4.0	53364-1227	12
0.8	5.8	4.9	3.2	53364-1027	10
D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

材料 MATERIAL 図中参照 SEE DRAWING				MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE				TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE				0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y ST. SMT (WITHOUT BOSS)	
角度 ANGLE	±3°	新規作成	M.N.	95/7/17	DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
30 以上 OVER	+0.3	RELEASED	M.N.	H.H.	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	+0.25	変更内容	DR.	日付	SD-53364-**-27
10 未満 UNDER	+0.2	REVISION RECORD	CHK.	DATE	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
		0			0

DWG. NO.
SD-53364-**-27



嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING (REF.)

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角度 ANGLE	±30					材料 MATERIAL	
30 以上 OVER	+0.3					SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	+0.25					仕上げ FINISH	— # —
10 未満 UNDER	+0.2					適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —
一般公差 GENERAL TOLERANCES						被覆外径 INS. RANGE	— # —
記号 LTR	0	新規作成 RELEASED (JC60025)	M.N.H.H.	95/7/17		DRAWN BY '95/7/17 M.NAKAMURA	CHK'D BY '95/7/17 Y.M.H.HIRAMOTO
変更内容 REVISION RECORD						APP'D BY '95/7/17 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE
DR. CHK.							
日付 DATE							

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.8 BOARD TO BOARD CONN.
WAFER ASS'Y ST. SMT
(WITHOUT BOSS)

DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV
SD-53364-**-27 0

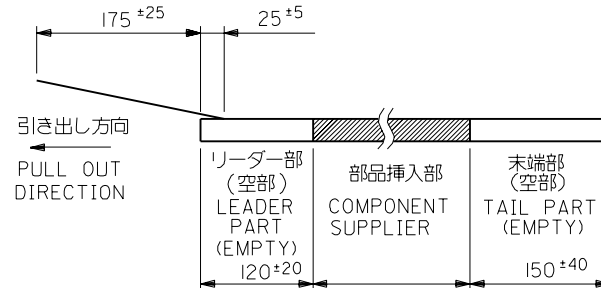
DWG. NO. SD-53364-***91

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

注記 NOTES

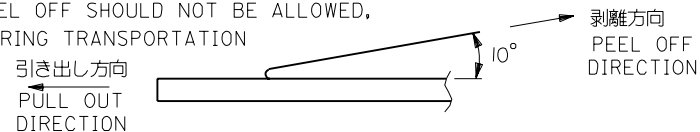
1. 梱包数量: 1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE リーダー部 LEADER PART
 トップテープ TOP TAPE 未接着部 NON-BONDED PART

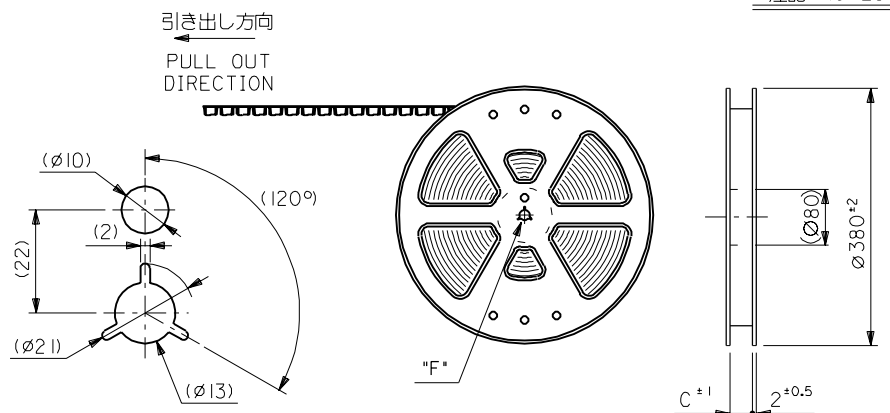


3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)
 0.1N ~ 0.7N (10.2gf ~ 71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
 (但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

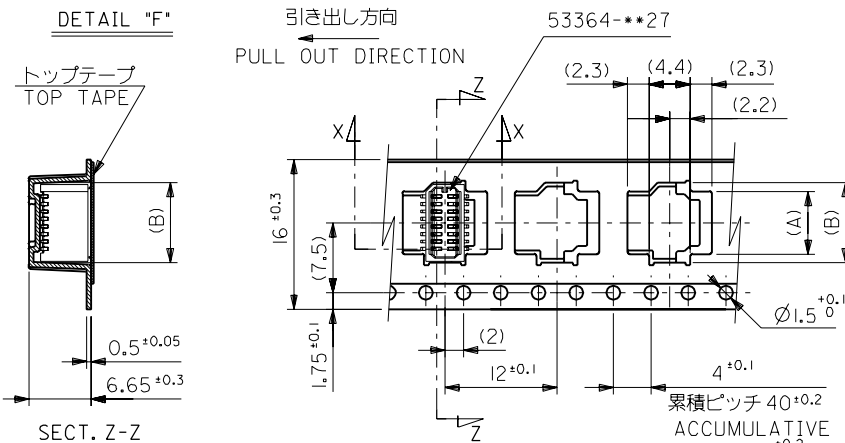
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
 0.1N ~ 0.7N (10.2gf ~ 71.4gf) (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
 THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
 PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION



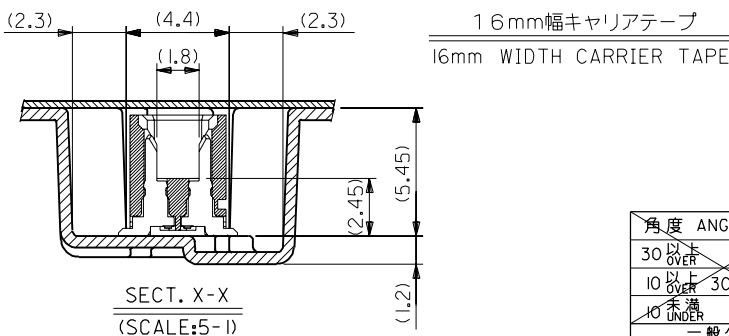
4. 材料 MATERIAL
 キャリアテープ: ポリプロピレン (PP) CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE
 トップテープ: PET, PE, PEF TOP TAPE: PET, PE, PEF
 リール: ポリスチレン (PS) REEL: POLYSTYRENE (PS)
 <リサイクル材を含む> <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>



DETAIL "F"



SECT. Z-Z



SECT. X-X (SCALE: 5-1)

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	+0.3
10°以下 UNDER	-0.25
30°未満 UNDER	±0.2
10°未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD

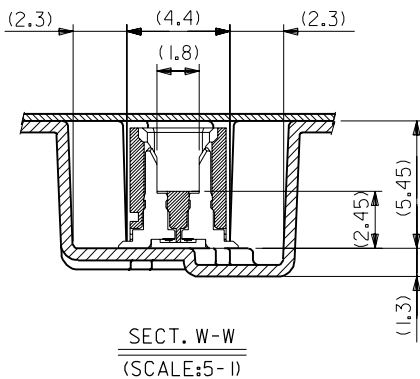
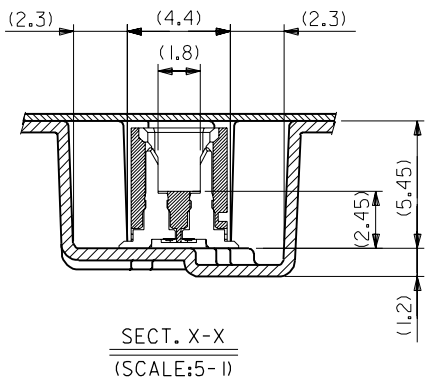
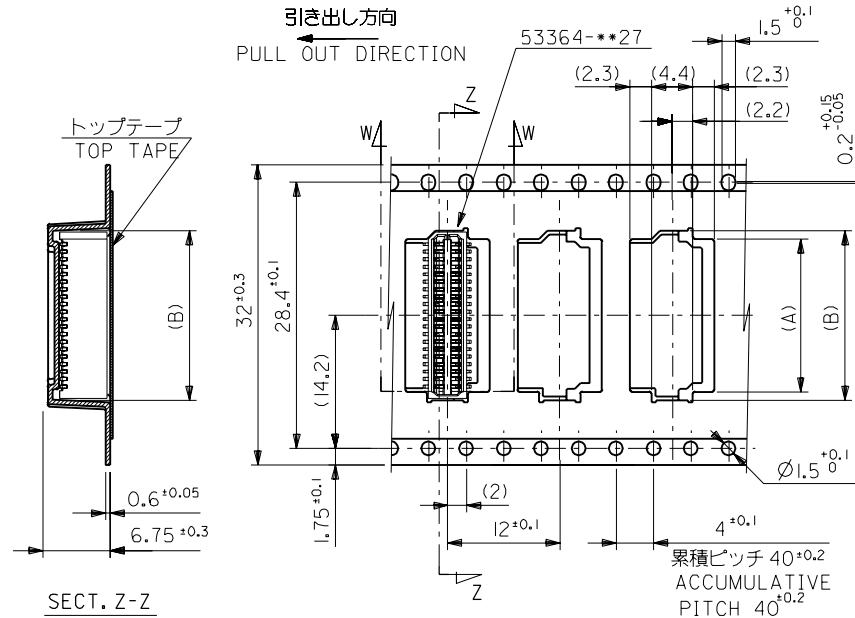
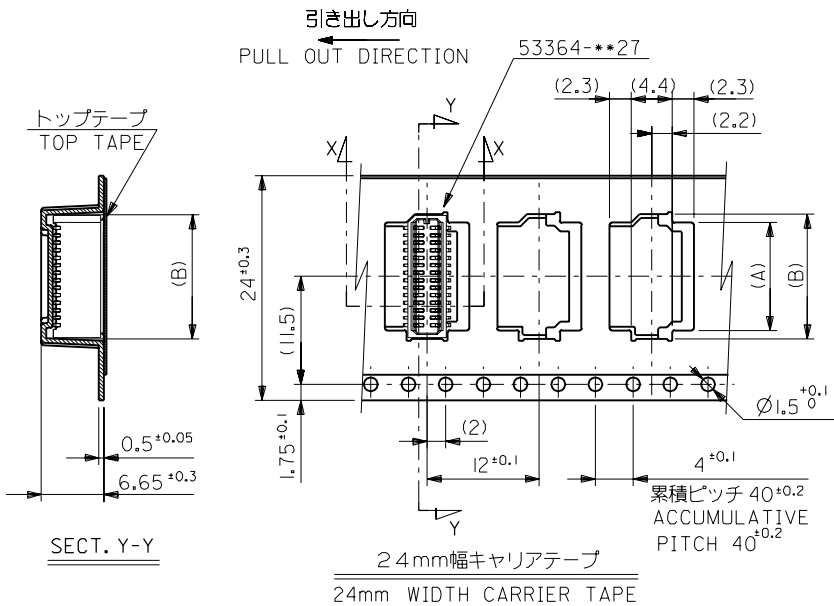
16	17.5	9.3	7.5	53364-1891	18
		6.9	5.1	53364-1291	12
		6.1	4.3	53364-1091	10
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C (B)	(A)	ENG. NO.		極数 CIRCUIT
材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES				
仕上げ FINISH	—				
適用電線範囲 WIRE RANGE	—				
被覆外径 INS. RANGE	—				
DRAWN BY '93/1/28 T.ITO	CHK'D BY '00/12/16 T.ITO				
DATE	尺度 SCALE	—			
DR. M.FUKUSHIMA	REV. C				

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
0.8 B+B Conn Wafer Assy ST SMT Without Boss Embstp Pkg	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)	REV C
SD-53364-***91	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-OIC(032)MXJ-32

5949932A.S03

DWG. NO.
SD-53364-**-91



32	33.5	18.9	17.1	53364-4291	42
		18.1	16.3	53364-4091	40
24	25.5	16.5	14.7	53364-3691	36
		14.1	12.3	53364-3091	30
		13.3	11.5	53364-2891	28
		10.1	8.3	53364-2091	20
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		C	(B)	(A)	極数 CIRCUIT

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH	—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE	—		TITLE 名称 0.8 B+B Conn Wafer Assy ST SMT Without Boss Embstp Pkg	
被覆外径 INS. RANGE	—		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53364-**-91 C	
DRAWN BY '93/1/28 T.ITO	CHK'D BY '00/12/6 T.ITO	尺度 SCALE	—	

角度 ANGLE	±3°	C	変更 REVISED (JC2001-0421)	K-K	'00/12/6
30以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISED (J40748)	T-A	'94/3/29
10以上 30 UNDER	+0.25	A	変更 REVISED (J30653)	TI	'93/6/30
10 UNDER	+0.2	O	新規作成 PROPOSED (J30088)	TI	'93/1/28
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHR.	日付 DATE	APP'D BY '00/12/6 M.FUKUSHIMA

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

5949932A.S04